

第58回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2026年9月16日（水）12:50～16:50

場所：大阪大学中之島センター 10階 第1・第2ホール

プログラム

12:50～13:00 委員会議事

司会 出田 吾朗（三菱電機）

13:00～13:40

『勘や経験に頼らない設計AIによるリニアモータ開発』（40分）

.....○太田 智浩（パナソニックホールディングス 株式会社）

13:40～14:20

『半導体パッケージの熱抵抗測定技術』

.....○東条 三秋（シーマ電子 株式会社）

14:20～15:00

『閾値変動形状融合法を用いた低熱抵抗ヒートシンク設計』

.....○浅井 勇吾（パナソニックインダストリー 株式会社）

15:00～15:10 休憩

司会 井上 雅博（群馬大学）

15:10～15:50

『接着から解体までを設計する～易解体性材料が拓く循環型ものづくり～』（40分）

.....○舘 秀樹（独立行政法人 大阪産業技術研究所）

15:50～16:20

『先端半導体材料の放熱用途向け酸化亜鉛の開発』（30分）

.....○大隅 崇靖（堺化学工業 株式会社）

16:20～16:50

『先端半導体材料向け球状アモルファスシリカの開発』（30分）

.....○谷川 弘樹（堺化学工業 株式会社）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会